



주요 특징

- 와트당 더 높은 성능을 제공하여 비용 효율성 향상
- 유연한 설계로 간단하게 관리 및 서비스
- 탄력적인 아키텍처를 통해 가용성을 유지하고 위험 감소



IBM System x3550 M3

컴팩트형 설계에 최적의 컴퓨팅 성능 제공

혁신적 기술을 슬림형 패키지에 제공

IBM System x3550 M3은 최신 Intel® Xeon® 프로세서 기술 위에 구축되며 최고의 처리 성능과 우수한 에너지 관리 및 냉각 기능을 제공합니다. x3550 M3은 이전 모델보다 두 배 많은 성능을 제공하고 낮은 전압의 구성 요소로 이루어진 유연한 에너지 스마트형으로 설계되었으므로 더 낮은 와트당 비용으로 더 많은 워크로드를 처리할 수 있습니다.

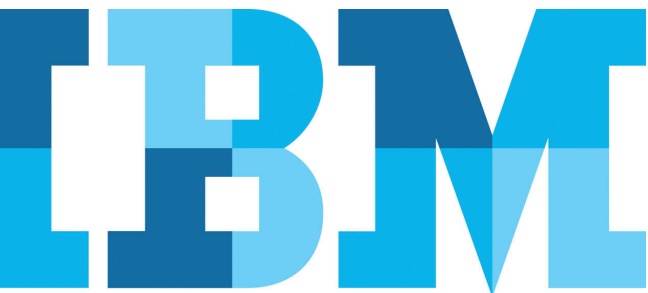
간단한 관리 및 서비스

x3550 M3은 유연하고 확장 가능하게 설계되었으므로 하드 디스크 드라이브를 4개에서 8개로 간단하게 업그레이드할 수 있습니다. 종합적 시스템 관리 도구(예: 고급 진단 기능, 단일 지점에서 자원을 제어하는 기능)로 인해 쉽게 배치, 통합, 서비스, 관리할 수 있습니다.

위험 감소 및 가용성 유지

새로운 6 Gbps RAID 어댑터가 내장되고 I/O 성능이 두 배 증가한 x3550 M3은 업무 핵심 애플리케이션 및 가상화 환경에 이상적인 탄력적 아키텍처를 제공합니다. 고급 메모리 지원 및 증가한 디스크 용량으로 처리 속도는 더욱 빨라졌으며 가동 시간은 그대로 유지됩니다.

x3550 M3의 선택 구성은 IBM Express Advantage™ Portfolio의 일부이며 중견기업의 요구사항에 맞게 설계되었습니다. 관리가 용이한 Express™ 모델과 구성은 국가별로 다양합니다.





IBM System x3550 M3 개요

폼 팩터/높이	랙/1U
프로세서(최대)	최대 2개의 3.33 GHz 6코어 (3.46 GHz 4코어) Intel Xeon 5600 시리즈 프로세서, QPI (QuickPath Interconnect) 기술 사용, 최대 1,333 MHz 메모리 액세스 속도
프로세서 개수(표준/최대)	1
캐시(최대)	최대 12 MB L3
메모리(최대)	18개 DIMM 슬롯을 사용하여 192 GB DDR-3 RDIMM ¹ 또는 12개 DIMM 슬롯을 사용하여 48 GB DDR-3 UDIMM ¹
확장 슬롯	2
디스크 베이(총계/핫스왑형)	최대 8개의 2.5" 핫스왑형 SAS (Serial Attached SCSI), SATA (Serial ATA) HDD 또는 SSD (Solid-State Drive)
최대 내장 스토리지	최대 4.0 TB 핫스왑 SAS 또는 최대 4.0 TB 핫스왑 SATA 또는 최대 400 GB 핫스왑 SSD 스토리지
네트워크 인터페이스	내장형 2포트, 추가 2포트(기가비트 이더넷 옵션)
전원 공급 장치(표준/최대)	1/2, 각각 675 W
핫스왑형 구성요소	듀얼 전원 공급 장치/팬 모듈, 디스크
RAID 지원	하드웨어 RAID-0, -1, -1E 또는 RAID-0, -1, -10(추가 옵션으로 자체 암호화 디스크 (SED) 기능을 사용하는 RAID-5) 또는 RAID-0, -1, -10, -5, -50 및 256 MB 또는 512 MB 캐시 포함(추가 옵션으로 RAID-6, -60(SED 기능 사용) 및 추가 옵션으로 배터리 백업) (모델에 따라 다름)
시스템 관리	원격 관리 실행 옵션을 위한 가상 미디어 키를 갖춘 IBM IMM(통합 관리 모듈), Predictive Failure Analysis, 통합 서비스 프로세서, 진단 LED, 광경로 진단 패널, 자동 서버 재시작, IBM Systems Director 및 IBM Systems Director Active Energy Manager™, IBM ServerGuide
지원되는 운영 시스템	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 및 2008, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server 및 VMware ESXi 4.0 내장형 하이퍼바이저
보증	3년 고객 교체 가능 유닛(CRU) 및 현장 제한 보증

© Copyright IBM Corporation 2010

IBM Systems and Technology Group
Route 100
Somers, New York 10589

Produced in the United States of America
2010년 3월
All Rights Reserved

IBM, IBM 로고, ibm.com 및 System x는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 이러한 또는 다른 IBM 상표 용어가 상표 기호(® 또는 ™)와 함께 정보에 처음 표시된 경우, 이런 기호는 IBM이 해당 정보를 출판할 당시 소유한 미국 등록 상표 또는 보통법 상표를 나타냅니다. 그런 상표는 또한 다른 국가에서도 등록 상표 또는 보통법 상표일 수 있습니다. 현재 IBM 상표 목록은 다음 웹사이트인 "저작권 및 상표 정보"에서 확인할 수 있습니다.
ibm.com/legal/copytrade.shtml

Intel 및 Intel Xeon은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 자회사의 등록 상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용하는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

Microsoft는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

다른 제품, 회사 또는 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스 마크입니다.

¹2010년 2분기에 16 GB DIMM을 출시하면 RDIMM은 최대 192 GB를 지원하고, 2010년 2분기에 4 GB DIMM을 출시하면 UDIMM은 최대 48 GB를 지원합니다.



재활용하십시오

추가 정보

월드 와이드 웹

미국 ibm.com/systems/x/

캐나다 ibm.com/systems/ca/en/servers/x/index.html